

公司代码：600460

公司简称：士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司
2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	士兰微	600460	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈越	马良
电话	0571-88210880	0571-88212980
办公地址	浙江省杭州市黄姑山路4号	浙江省杭州市黄姑山路4号
电子信箱	600460@silan.com.cn	ml@silan.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,430,622,341.26	8,913,260,192.08	5.80
归属于上市公司股东的净资产	3,420,625,148.80	3,378,978,407.39	1.23
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-73,251,809.79	-55,774,773.75	不适用
营业收入	1,704,924,822.31	1,440,309,555.89	18.37
归属于上市公司股东的净利润	30,630,637.82	57,812,582.87	-47.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,220,531.49	-10,844,899.10	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.90	1.67	减少0.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.023	0.044	-47.73
稀释每股收益(元/股)	0.023	0.044	-47.73

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				151,704		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股 比例 (%)	持股 数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结的股份数 量	
杭州士兰控股有限公司	境内非国 有法人	39.14	513,503,234	0	质押	140,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.37	31,071,900	0	无	0
厦门半导体投资集团有限公司	国有法人	1.62	21,276,595	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华 夏国证半导体芯片交易型开放式 指数证券投资基金	其他	1.57	20,636,849	0	无	0
中国银行股份有限公司－国泰 CES 半导体行业交易型开放式指 数证券投资基金	其他	1.00	13,155,715	0	无	0
陈向东	境内自然人	0.94	12,349,896	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.86	11,270,971	0	无	0
范伟宏	境内自然人	0.81	10,613,866	0	无	0
国泰君安证券股份有限公司－国 联安中证全指半导体产品与设备 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.68	8,893,919	0	无	0
郑少波	境内自然人	0.64	8,374,553	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至报告期末，在册持有本公司股份前十名无限售 条件股东中的陈向东、范伟宏、郑少波等三人为本公司 第一大股东杭州士兰控股有限公司之股东。其他前十大 持有无限售条件的股东之间未知是否存在关联关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

☐适用 ☒不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

☐适用 ☒不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，尽管面对新型冠状病毒肺炎疫情、中美贸易摩擦加剧，全球经济增速放缓的压力，但公司总体营业收入增速明显加快，这体现出公司近些年持续高强度的研发投入取得了积极成效，公司在特色工艺平台建设、新产品开发、战略级大客户合作等方面持续取得突破，产品结构调整的步伐明显加快。

2020 年上半年，公司营业总收入为 170,492 万元，较 2019 年同期增长 18.37%；公司营业利润为-3,077 万元，比 2019 年同期减少 2,377 万元；公司利润总额为-3,045 万元，比 2019 年同期减少 2,326 万元；公司归属于母公司股东的净利润为 3,063 万元，比 2019 年同期减少 47.02%。2020 年上半年公司经营利润下降的原因主要是因为：（1）公司子公司士兰集昕公司 8 英寸芯片生产线仍处于特色工艺平台建设阶段，2020 年上半年持续在高端功率器件、高压集成电路、MEMS 传感器等产品的研发上加大投入，导致报告期内仍然有一定幅度的亏损。（2）公司子公司士兰明芯公司和美卡乐光电公司受新型冠状病毒肺炎疫情影响，接获的客户订单数量下降较多（有部分客户延迟交货），导致发光二极管产品（主要为 LED 彩色显示屏芯片和成品）的销售收入较去年同期下降较多，亏损进一步增加。

2020 年上半年，公司集成电路的营业收入为 5.38 亿元，较去年同期增长 9.55%，公司集成电路营业收入增加的主要原因是：公司各类电路新产品的出货量明显加快。预计下半年公司集成电路的营业收入增速还将进一步提高。

2020 年上半年，公司 IPM 功率模块产品在国内白色家电（主要是空、冰、洗）、工业变频器等市场继续发力，上半年 IPM 营业收入突破 1.6 亿人民币，较去年同期增长 90%以上。2020 年上半年，国内多家主流的白电整机厂商在变频空调等白电整机上使用了超过 600 万颗士兰 IPM 模块，预期今后几年将会继续快速成长。

2020 年上半年，公司电控类 MCU 产品持续在工业变频器、工业 UPS、光伏逆变、纺织机械类伺服产品、各类变频风扇类应用以及电动自行车等众多领域得到了广泛的应用。

2020 年上半年，全部芯片自主研发的电动汽车主电机驱动模块，已通过部分客户测试并开始接获小批量订单。

2020 年上半年，公司语音识别芯片和应用方案持续在国内主流的白电厂家的智能家电系统中推广，并得到较为广泛的应用。

2020 年上半年，公司 MEMS 传感器产品营业收入较去年同期增加 70%以上，部分国内手机品牌厂商已开始应用公司 MEMS 传感器产品。加速度传感器、硅麦克风等产品已在 8 吋线上实现了批量产出。随着，公司 MEMS 传感器产品在智能手机、平板电脑、智能手环、智能门锁、行车记录仪、TWS 耳机、白色家电、工业控制等领域持续拓展，预计今后 MEMS 传感器产品的出货量还将进一步增长。

2020 年上半年，公司开发的针对智能手机的快充芯片组，以及针对旅充、移动电源和车充的多协议快充解决方案的系列产品，已在国内手机品牌厂商等到应用，出货量有显著提高。

2020 年上半年，公司分立器件产品的营业收入为 9.21 亿元，较去年同期增长 35.64%。分立器件产品中，MOSFET、IGBT、IGBT 大功率模块（PIM）、肖特基管、开关管、稳压管、快恢复管等产品的增长较快。除了加快在白电、工业控制等市场拓展外，公司已开始规划进入新能源汽车、光伏等市场，预期公司的分立器件产品未来几年将继续快速成长。

2020 年上半年，公司子公司士兰集成基本处于满负荷生产状态，总计产出芯片 115.68 万片，比去年同期增加 8.58%；士兰集成通过加强成本控制，经营利润已有明显回升。

2020 年上半年，公司子公司士兰集昕公司总计产出芯片 23.723 万片，比去年同期增加 34.77%。上半年，士兰集昕产出持续增加，6 月份已实现月产出 8 英寸芯片 5 万片的目标。随着高压集成电路、高压超结 MOS 管、高密度低压沟槽栅 MOS 管、TRENCH 肖特基管、大功率 IGBT、MEMS

传感器等多个产品导入量产，士兰集昕营业收入较去年同期增加 50%。2020 年下半年，士兰集昕将进一步加大对生产线投入，提高芯片产出能力。今后，随着士兰集昕产能进一步释放，以及产品结构调整加快，士兰集昕将实现盈利。

2020 年上半年，公司子公司成都士兰公司外延芯片车间继续保持稳定生产，模块车间功率器件、功率模块封装线的产出实现较快增长。2020 年下半年，公司将进一步提升模块车间的封装能力。

2020 年上半年，公司发光二极管产品的营业收入为 1.39 亿元，较去年同期减少 33.08%。发光二极管产品营业收入减少的主要原因是：目前，公司子公司士兰明芯公司和美卡乐光电公司的产品主要是针对 LED 彩色显示屏市场，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，彩屏用芯片和成品（美卡乐彩色像素管）的订单数量下降较多，导致士兰明芯和美卡乐的产能利用率较低，亏损进一步增加。对此，士兰明芯加快了高亮度 LED 白光芯片等产品的开发，加快进入中高端 LED 芯片市场，美卡乐推出了高品质的“4 合 1”产品，加大了国内市场开拓力度，预计下半年士兰明芯和美卡乐营业收入将逐步回升。

2020 年上半年，厦门士兰明镓公司已完成部分新产品的研发并进入试生产阶段，6 月份已实现首批产品的销售，目前士兰明镓正在加快新产品开发进度，争取在四季度实现产能的释放。

2020 年上半年，厦门士兰集科公司已完成后段工艺设备的安装和调试，预计在三季度完成前段工艺设备的安装和调试，争取在年底前实现通线。

经过 20 多年的发展，公司已成为目前国内最主要的以“设计制造一体”（IDM）模式为特色的综合型半导体产品公司之一。作为 IDM 公司，公司带有资产相对偏重的特征，在外部经济周期变化的压力下，也会在一定程度上承受经营利润波动的压力。但是相对于轻资产型的 Fabless 设计公司，公司在特色工艺和产品的研发上具有更突出的竞争优势：实现了特色工艺技术与产品研发的紧密互动，以及半导体器件、集成电路和模块产品的协同发展；公司依托 IDM 模式形成的设计与工艺相结合的综合实力，提升产品品质、加强控制成本，向客户提供差异化的产品与服务，提高了其向大型厂商配套体系渗透的能力。随着 8 吋芯片生产线项目投产，以及化合物半导体器件生产线项目和 12 吋芯片特色工艺芯片生产线项目建设加快推进，将持续推动士兰微电子整体营收的较快成长。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

☒ 适用 ☐ 不适用

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”）的相关要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，将本年年初合并资产负债表和母公司资产负债表中的“预收款项”7,253,953.99 元和 3,409,037.70 元调整至“合同负债”项目列报。本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。具体内容详见本财务报告附注之“重要会计政策变更”。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

☐ 适用 ☒ 不适用

董事长：陈向东

杭州士兰微电子股份有限公司

2020 年 8 月 14 日